

スイッチボディ高さ 1.4mm 超小型タクティールスイッチ TSW-8 / 8A シリーズ

■特長

- 外形サイズ 3.2x4.1mm、スイッチボディ高さ 1.4mm の超小型で高密度実装に適した表面実装タイプ。
- キータッチはタクティールフィードバック特性を活かしたシャープなクリック感触。
- 端子形状はJベント、ストレート端子をシリーズ化、リフローハンダ付けが可能。
- 静電気放電対策に有効な金属カバーをハンダ付け可能タイプ。
- スイッチの供給は、12mm 幅エンボステーピング方式。

■用途

- デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ
- 各種オーディオ機器、VTR、カーナビ
- 携帯電話、携帯情報端末



■製品一覧

- ステム付きタイプ (TSW-8)

No	製品番号	作動力	移動量	端子形状	バラエティ	梱包数 / 1リール
1	TSW-8-16-T40	1.6N	0.15mm	Jベント	ガイドボス無し	4,000
1	TSW-8-16B-T40				ガイドボス付き	
2	TSW-8-1-16-T40			ストレート	ガイドボス無し	
2	TSW-8-1-16B-T40				ガイドボス付き	

- ステムフラットタイプ (TSW-8A)

No	製品番号	作動力	移動量	端子形状	バラエティ	梱包数 / 1リール
3	TSW-8A-16-T40	1.6N	0.15mm	Jベント	ガイドボス無し	4,000
3	TSW-8A-16B-T40				ガイドボス付き	
4	TSW-8A-1-16-T40			ストレート	ガイドボス無し	
4	TSW-8A-1-16B-T40				ガイドボス付き	

■主な仕様

項目	仕様
最大定格 (抵抗負荷)	50mA 12V DC
接触抵抗	100mΩ max. (初期値)
絶縁抵抗	100MΩ min. 100V DC
耐電圧	250V AC for 1minute
動作寿命	100,000 cycles
使用温度範囲	-20°C to +70°C
保存温度範囲	-40°C to +80°C (except carrier tape)

■外形図

単位 : mm

No	形状	P.C.Bランド参考図・回路構成図 (TOP VIEW)
1	<p>ステム付きタイプ Jベント端子 TSW-8-16-T40, TSW-8-16B-T40</p> <p>Ground Terminal (SUS Ag plating)</p> <p>Terminal No. 1</p>	<p>Circuit diagram 回路構成</p>
2	<p>ステム付きタイプ ストレート端子 TSW-8-1-16-T40, TSW-8-1-16B-T40</p> <p>Ground Terminal (SUS Ag plating)</p> <p>Terminal No. 1</p>	<p>Circuit diagram 回路構成</p>

図はガイドボス付きを表しています

図はガイドボス付きを表しています

図はガイドボス付きを表しています

■外形図

単位 : mm

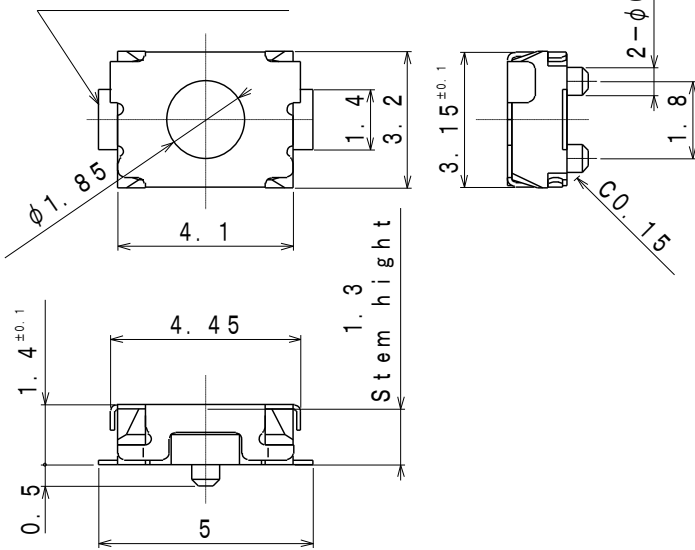
No	形状	P.C.Bランド参考図・回路構成図 (TOP VIEW)
3	<p>ステムフラットタイプ Jベント端子 TSW-8A-16-T40, TSW-8A-16B-T40</p> <p>Ground Terminal (SUS Ag plating)</p> <p>Terminal No. 1</p> <p>Stem height</p>	<p>P.C.Bランド参考図・回路構成図 (TOP VIEW)</p> <p>Circuit diagram 回路構成</p>
4	<p>ステムフラットタイプ ストレート端子 TSW-8A-1-16-T40, TSW-8A-1-16B-T40</p> <p>Ground Terminal (SUS Ag plating)</p> <p>Terminal No. 1</p> <p>Stem height</p>	<p>P.C.Bランド参考図・回路構成図 (TOP VIEW)</p> <p>Circuit diagram 回路構成</p>

図はガイドボス付きを表しています

ステムフラットタイプ ストレート端子
TSW-8A-1-16-T40, TSW-8A-1-16B-T40

Ground Terminal (SUS Ag plating)

Terminal No. 1



図はガイドボス付きを表しています

■注記

1. 製品改良などにより外観および記載事項の一部を予告なく変更する場合があります。
2. 当カタログは概略仕様です。ご使用に当たっては正式納入仕様書の取り交わしをお願い致します。
3. 別紙に掲載の『スイッチの使用上の注意』をご確認をお願いします。
4. テーピング梱包仕様は一覧に記載の数量/リールが最小梱包単位となります、ご注文につきましては最小梱包単位のN(整数)倍でご発注いただけますようご協力お願い致します。
5. リフロー条件の設定については、実際の量産条件で御確認ください。
6. 基板のソリによって特性が変化する場合がありますので、パターン設計、レイアウトについては、十分考慮願います。
7. 本ブッシュスイッチは、洗浄タイプではありませんので洗浄は行わないでください。
8. 本ブッシュスイッチは、リフロー半田対応であり、使いがって上基板の端に位置するケースが考えられますが、この場合スイッチ実装後にオートディップを行ないますと、フラックスがスイッチ内部へ入り込む危険性がありますのでスイッチ実装後にオートディップは行わないで下さい。
9. スイッチ操作時に規定以上の静荷重及び衝撃荷重を加えないで下さい。また、押しボタンの強度保護及び動作特性安定の為、押しボタン部への押圧は、全面へ均等に荷重が加わる構造とし、押しボタン端部等の特定の1ヶ所への加圧は避け下さい
10. 手付けハンダを行う場合、ハンダゴテは端子先端にあて端子に異常加圧のない様ご配慮願います。尚、ハンダ付け後、1分間はスイッチに力を加えない様願います。
11. 端子部にフラックス等の侵入のない様ご配慮願います。
12. カバー上面に力が加わると動作特性が変化しますので、加圧がない様ご配慮願います。